

### Q1. 公司如何看待 2026 下半年至 2027 半導體晶圓產業的整體展望？

A：  
公司觀察到半導體產業正逐步進入新一階段的成長循環，復甦動能已從先進製程擴展至更多應用領域，但不同產品與市場復甦步調仍有差異。

從中長期來看，產業發展可歸納為幾項關鍵趨勢，包括 AI 應用持續擴展至邊緣裝置與 Agentic AI，帶動高效能運算與先進製程需求；產業發展重心由單純追求出貨量，逐步轉向產品價值與技術升級；先進封裝與系統整合進一步提升單一終端裝置的半導體用量與整體矽含量的成長。然而，整體市場仍受地緣政治、關稅貿易政策、匯率波動、能源與原物料成本等不確定因素影響，公司將持續審慎管理並靈活因應市場變化。

### Q2. 12 吋晶圓與先進製程需求趨勢為何？

A：  
受 AI 與高效能運算應用帶動，12 吋晶圓需求維持穩健，除新建產線仍處於爬坡階段，相關產線保持高稼動。先進製程與高階產品需求相對明確，成為支撐產業成長的重要動能。

### Q3. 成熟製程與中小尺寸晶圓市場狀況如何？

A：  
成熟製程需求已逐步改善，特別在電源管理與類比應用帶動下，市場呈現回溫跡象，隨庫存去化進入後期，中小尺寸晶圓需求有機會持續回升。

### Q4. 環球晶圓全球擴產進度情形？

A：  
環球晶圓持續推進全球擴產與在地化布局，各主要廠區加速送樣與驗證並陸續收穫成果。日本宇都宮廠擴產完成後迅速轉為獲利並貢獻正向現金流；義大利廠新產線通過 IATF 16949 認證，顯示相關製程與品質管理已符合車用供應鏈的嚴格要求，有助加速客戶驗證與量產導入；美國德州新廠已取得一線客戶認證啟動產能提升；美國密蘇里州廠 12 吋 SOI 產線持續優化製程與產品組合，部分射頻與矽光子產品已於 2026 年第一季開始量產，為集團多項布局中率先顯現成果的亮點之一。

**Q5. 高附加價值產品發展進展為何？****A：**

隨著先進封裝技術及高效率、高頻應用推動新材料需求，環球晶圓持續布局高價值應用產品，包括 SOI、GaN 及 SiC 等領域。其中，SOI 產線受惠於客戶需求強勁與訂單能見度明朗，表現亮眼。在化合物半導體方面，12 吋 SiC 已完成研發並進入客戶驗證，後續將依認證進度逐步放量，推進應用於散熱、先進封裝及光學等領域；GaN 則聚焦高效能電源應用，涵蓋資料中心、充電基礎設施與智慧裝置，產能穩定並持續擴充，以支應長期需求。

**Q6. 先進封裝對晶圓需求帶來哪些影響？****A：**

先進封裝已成為提升系統效能之重要技術，推動對高規格晶圓的需求。隨封裝複雜度提升，晶圓規格與應用場景同步擴展，有助提升產品價值及產業長期需求能見度。

**Q7. 政府補助與財務結構對公司有何影響？****A：**

在政府補助方面，在 2026 年第一季，公司已取得美國與歐洲相關計畫支持，並持續推進相關申請，有助支應全球擴產與提升資本效率。同時，公司持續優化資產負債結構，隨營運動能逐步提升，財務體質亦持續強化。